

Nicht smart diskutieren – sondern SMART machen!

Längst sind die produzierenden OEM und EMS der Elektronikindustrie sowie ihre Zulieferer auf sehr gutem Weg, die digitale Transformation der Fertigungsstätten voranzubringen. Sie können auf einer guten Basis aufbauen: Verkettete Produktionssysteme, Datentransfer, EMS- und MES-Anbindungen, Traceability und intelligente Software-Lösungen waren bereits vorhanden und werden stetig weiterentwickelt.

Dennoch gilt es, neue Spielregeln zu entwickeln; nationale und internationale Kooperationen sind hierfür unabdingbar. Die vertikale Integration, also die digitale Vernetzung innerhalb eines Unternehmens, muss zukünftig ohne Software-Gaps funktionieren. Hierfür müssen ggf. neue Datenformate, Protokolle und Schnittstellen entwickelt sowie neue Hardware für den Datenaustausch zwischen den Produktionssystemen geschaffen werden.

Eine neue Herausforderung ist sicherlich, die horizontale Wertschöpfungskette über die Unternehmensgrenzen hinaus zu vernetzen und ‚smart‘ zu machen. Einen möglichen Ansatz hat Herr Heller auf dem Kongress ‚Wir gehen in die Tiefe‘ im Juni 2017 in Dresden vorgestellt: „Ausgangspunkt der Nokia SCM Global Operations ist es, überall dort zu automatisieren, wo es dem Fabrikationsprozess nutzt. Konsequenz werden in verschiedenen Standorten weltweit logistische Prinzipien, exzellente Datenverfügbarkeit und umfassendes Datenmanagement (Datenanalytik, Datenverarbeitung) miteinander verknüpft.“ Es geht also nicht darum, das Internet of Things an sich voran zu treiben, sondern konsequent die wirtschaftlichen und Wettbewerbs-Vorteile daraus zu nutzen.

Eine nationale Kooperation besteht z. B. im RIS-Projekt (RFID in der Surface Mount Technology). Unter Mitarbeit von ASM, Beta Layout, Harting, Kasper,

Kraus Hardware, Murata, Nokia, Rehm, Steca, TU Dresden und Zollner wird das Ziel verfolgt, eine smarte SMD-Linie aufzubauen, die in der Lage ist, Daten zwischen den zu fertigenden elektronischen Baugruppen und den einzelnen Fertigungseinrichtungen online auszutauschen. Neue Chip-Familien lassen die Vision des intelligenten Produkts, das seinen Fertigungszustand selbst speichern und kommunizieren kann, greifbar nahe erscheinen.

Neue politische Initiativen treiben die internationale Kooperation voran. Die deutsche Plattform Industrie 4.0, die französische Alliance Industrie du Futur und die italienische Initiative Piano Industrie 4.0 wollten sich mit folgenden drei Kernthemen befassen, wie auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft im Juli 2017 zu lesen war:

- Schaffung von gemeinsamen Standards und Referenzarchitekturmodellen
- Wege zu ebnen, um die Digitalisierung für KMU zugänglicher zu machen
- Die Politik soll günstige Rahmenbedingungen schaffen, damit die Industrie von der Digitalisierung profitieren kann

Es hat sich viel getan, seitdem die Bundesregierung erstmals 2006 eine

Hightech-Strategie für Deutschland verkündet hat und sich die Wirtschaftsverbände Bitkom, VDMA und ZVEI 2013 zu der Plattform Industrie 4.0 verständigt haben. Uns aus dem Elektronik produzierenden und liefernden Gewerbe muss vor einer digital vernetzten Industrie nicht bange sein, denn wir gestalten sie tagtäglich selbst mit – wir machen!



Dr. Hans Bell

Rehm Thermal Systems